附件5

江苏省集成电路封装、测试企业

留存备查资料

**企业名称（盖章）：**

**所 在 地 区： 市 区（县）**

**填 报 日 期： 年 月 日**

**材料目录**

一、承诺书

二、申请表

三、附件材料

□ 1、企业法人营业执照副本

□ 2、企业取得的相关资质证书

□ 3、企业人员结构情况说明（格式一）

□ 4、汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证、聘用合同）等相关证明材料

□ 5、企业研究开发人员名单（格式二）

□ 6、企业研发机构设置、研发项目开展情况表（格式三）

□ 7、企业开发销售的主要产品（服务）列表（格式四）

□ 8、企业拥有的与集成电路封装、测试相关的不少于5项已授权发明专利、软件著作权证书材料

□ 9、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）

□ 10、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路封装、测试销售（营业）收入情况表

□ 11、经具有资质的中介机构鉴证的企业研究开发费用情况表；

□ 12、与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件

□ 13、企业具有与开展集成电路封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料

□ 14、企业所得税年度纳税申报表（附表A107042）（应与纳税申报表数据一致）

□ 15、其他材料：

一、承 诺 书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

年 月 日

二、申 请 表

**（一）企业概况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（中文） | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称（英文） | | | |  | | | | | | | | 企业网址 | | | |  | | | |
| 注册地址 | | | |  | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  | | | |
| 联系地址 | | | |  | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  | | | |
| 法定代表人 |  | | | | 电 话 | | |  | | | 身份证/护照号 | | | |  | | | | |
| 联系人 | |  | | | 联系人手机 | | |  | | | 联系人电邮 | | | |  | | | | |
| 企业注册日期 | | | |  | | | | | 组织机构代码 | | | |  | | | | | | |
| 企业注册资金  （万元） | | | |  | | | 投资总额（万元） | | | |  | | | 初始获利年度 | | | | |  |
| 企业性质 | | | | □国有 □外商独资 □中外合资 □民营 □其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否上市企业 | | | | □是 （上市地点及日期 ） □否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否高新技术企业 | | | | □是 □否 | | 高新技术企业认定有效期 | | | |  | | 高新技术企业认定证书号 | | | | | |  | |
| 主管税务机关 | | | |  | | | | | 纳税人识别号(社会信用代码) | | |  | | | | | | | |
| 主要股东及  持股情况 | | | |  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |

**（二）主要业务及产品**（请在□内打√，其它请见详细说明）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业类型**  □ 集成电路封装 □ 集成电路测试  **主要业务**    **□集成电路封装**  **封装类型** □ 晶圆级封装 □系统级封装 □2.5D和3D封装  □ DIP □ SOP/SOJ □ QFP □ LCC □ BGA/PGA □ MCP □ SIP  □ 其它 、 、 、 、  **□集成电路测试**  **中测圆片直径** □ 12英寸 □ 8英寸 □6英寸 □5英寸 □ 4英寸  **成测封装类型** □ DIP □SOP/SOJ □ QFP □ LCC □ BGA/PGA □MCP □SIP  □ 其它 、 、 、 、  **备注：** | | | | | | |
| 与集成电路封装、测试相关的已授权的发明专利数量（件） | |  | 与集成电路封装、测试相关的正在受理的发明专利数量（件） |  | 与集成电路封装、测试相关的计算机软件著作权（项） |  |
| 质量  认证  情况  通 | □已通过 □尚未通过 如通过认证请列出取得证书的名称：  1、  2、  3、  4、 | | | | | |

**（三）生产开发环境**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生  产  环  境 | 生产厂房面积(M2) | |  | | | |
| 生产设备总数（台/套） | |  | | | |
| 减薄设备 | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 贴片机 | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 划片机 | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 键合机 | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 倒装设备 | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 塑封机 | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 测试台 | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 其它： | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 其它： | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |

**（四）申报企业人员构成情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年月平均  职工总数  （名） |  | 大专以上学历月平均职工数（名） |  | 企业研发人员数（名） |  |
| 大专以上学历月平均职工人数占当年月平均职工总数比例（%） |  | 研发人员占当年月平均职工总数比例（%） |  |
| 硕士学历职工人数 | |  | 博士学历职工人数 | |  |

**（五）企业情况简介**

|  |
| --- |
| 企业情况简介（包括：企业主要产品、生产能力、生产工艺和技术水平、行业地位、市场情况，知识产权成果，以及企业发展规划和有关建议）。 |
| 企业汇算清缴年度是否发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为： |

**（六）企业上年度经营情况** 单位：万元(外币换算成人民币，保留到整数)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业销售（营业）收入总额 | |  | | | 内销 | |  | 出口 |  |
| 集成电路封装、测试销售（营业）收入 | |  | | | 集成电路封装、测试销售（营业）收入  占企业收入总额比例（%） | | | |  |
| 集成电路产品  代销收入 | |  | | | 其他收入 | | | |  |
| 研究开发费用总额  （万元） | |  | | | 研究开发费用总额占企业  销售（营业）收入总额的比例（%） | | | |  |
| 中国境内研究开发费用（万元） | |  | | | 境内研究开发费用占研究  开发费用总额的比例（%） | | | |  |
| 利润总额 | |  | | | 纳税总额 | | | |  |
| 资产总计 | |  | | | 固定资产净值 | | | |  |
| 总产量（万片、万支、万块、万台、或其它单位）\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 承担各级政府  项目情况（实施中的项目） | □ 已承担  □ 未承担 | | | 国家级项 项； 省级 项； 地市级 项； 其他 项。  承担项目基本情况描述：  科研经费拨款总额： （万元）  \*注：科研经费拨款主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。 | | | | | |
| 财务负责人（签字）：  企业财务章  年 月 日 | | | | | | 企业法定代表人或负责人（签字）  企业公章  年 月 日 | | | |
| 备 注 | | |  | | | | | | |

**部分附件材料参考样式：**

格式一

**企业人员结构情况说明**

**一、我公司人员构成情况**：

月平均职工总数为 名，其中：具有劳动合同关系的 名；劳务派遣 名；具有聘用关系 名（需提供相应证明材料）。

大专及以上学历月平均职工人数 名（大专 名、本科 名、硕士 名、博士 名），占企业月平均职工总人数的比例 %。

**二、我公司研究开发人员情况：**

研究开发人员月平均数 名，

占企业月平均职工总数的比例 %。

**三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：**

企业名称： （公章）

年 月 日

格式二

**企业研究开发人员名单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **社保编号** | **研发工作岗位/内容** | **学历** | **职称** | **入职时间** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

格式三

**企业研发机构设置、研发项目开展情况表**

3-1 企业研发机构设置情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业研发机构名称** | **批准机关/自建** | **设立时间** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3-2 汇算清缴年度企业开展研究开发项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | **项目级别** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：项目级别按照下达项目的部门分为：国家、省、地方、自选

格式四

**企业主要集成电路封装、测试产品（服务）列表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **产品（服务）名称** | **规格/型号** | **关键性能指标** | **年产量/单位** | **销售额**  **（万元）** | **主要客户** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

全年集成电路封装、测试销售合计： 万元。

**注意事项**

1、附件材料如无特别指明，可以提供复印件（须盖章证明）。

2、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。

3、《申请表》中：企业销售（营业）总额=内销+出口=集成电路封装、测试销售收入（包括自主集成电路产品封装、测试收入和代加工集成电路产品封装、测试收入）+代销集成电路产品收入+其他收入（如：非集成电路业务销售收入、服务收入、国家项目开发费等），即《企业所得税法》第六条规定的收入总额。如有其他收入请在备注栏内写明内容和金额。

4、《申请表》中：“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数）÷2；当年月平均职工总人数＝当年各月平均职工总人数之和÷12。“具有大学专科及以上学历月平均职工人数”的计算方法同上。

5、除另有说明外，表中栏目不得空缺。表中选取项目请在“□”中划“√”，要求排序的项目请填写所排序号。表中要求签章处，须加盖公章，复印无效。

6、研究开发费用的政策口径，按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）等规定执行。

7、留存备查资料是根据国家、江苏省有关规定要求必须提供的，申报单位应真实、完整提供，并且能够与《申报表》中填报的数据相互印证，否则将影响核查结果。

8、《江苏省集成电路封装、测试企业留存备查资料》按照“封面、材料目录、承诺书、申请表、附件材料”的顺序装订成册，并同时提交“申请材料”的电子文档。